

2012年5月1日

リコー、第3世代 Core i シリーズ対応マザーボード「FB19M」を新発売

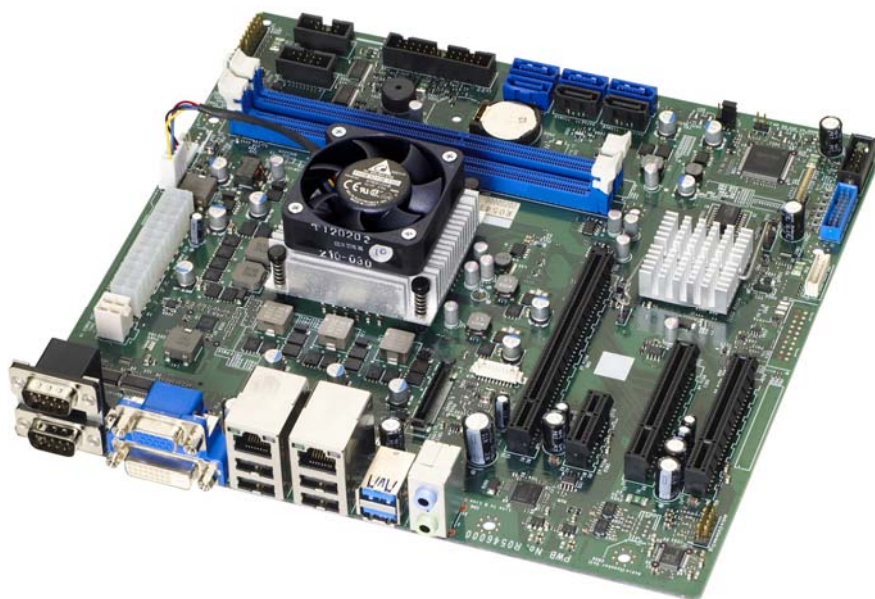
株式会社リコー(社長執行役員:近藤史朗)は、インテル最新のMobile系チップセット“Intel® HM76”搭載の組込み機器用Micro ATXマザーボード「FB19M」を発売いたします。

製品名	FB19M
対応CPU	第3世代Core iシリーズ
標準価格	オープン価格
発売日	2012年5月上旬
目標販売数	30,000枚

「FB19M」は、Mobile系の最新チップセットである“Intel® HM76”を搭載した組込み機器用Micro ATXマザーボードです。幅広いCPUバリエーションへの対応が可能となりました。また高速なPCI Express×8カードを2枚実装可能であり、これらはGen3(最大8Gpbs)に対応しています。さらに、USB3.0インターフェースに対応しました。

<FB19Mの主な特長>

- 1. Mobile系最新チップセット Intel® HM76 を搭載**
Intel® HM76を採用することにより、22nm版Mobile系CPU“第3世代Core iシリーズ”に対応しました。また、小型プロセッサと3次元トランジスタ構造により、第2世代Core iシリーズに比べ、高速・低消費電力・高密度化を実現しました。
- 2. CPUの内蔵グラフィック性能が大幅向上**
外部:アナログRGB, DVI-D, 内部:LVDSの合計3系統から同時2画面(独立)出力が可能になりました。これにより、第2世代Core iシリーズに比べ、CPUの内蔵グラフィック性能が大幅向上しました。
- 3. PCI Express×8を2枚実装可能**
拡張スロットにPCI Express×8を2本用意し、高速I/Oカードの複数構成に対応しました。
- 4. USB3.0インターフェースに対応**
USB3.0インターフェース(内部、外部に各2ポート)に対応しました。



FB19M(外観)

| リコーグループについて |

リコーグループは、オフィス向け画像機器、プロダクションプリントソリューションズ、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービスなどを世界200以上の国と地域で提供するグローバル企業です(2012年3月期リコーグループ連結売上は1兆9,034億円)。

人と情報のかかわりの中で新しい価値を生む製品、ソリューション、サービスを中心に、デジタルカメラや産業用の製品など、幅広い分野で事業を展開しています。高い技術力に加え、際立った顧客サービスや持続可能社会の実現への積極的な取り組みが、お客様から高い評価をいただいています。

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。

より詳しい情報は、下記をご覧ください。

www.ricoh.co.jp/about/